

タツモ株式会社 決算説明資料

2023年12月期第2四半期

2023年8月10日発表

タツモ株式会社



会社案内ダウンロード



単位：百万円

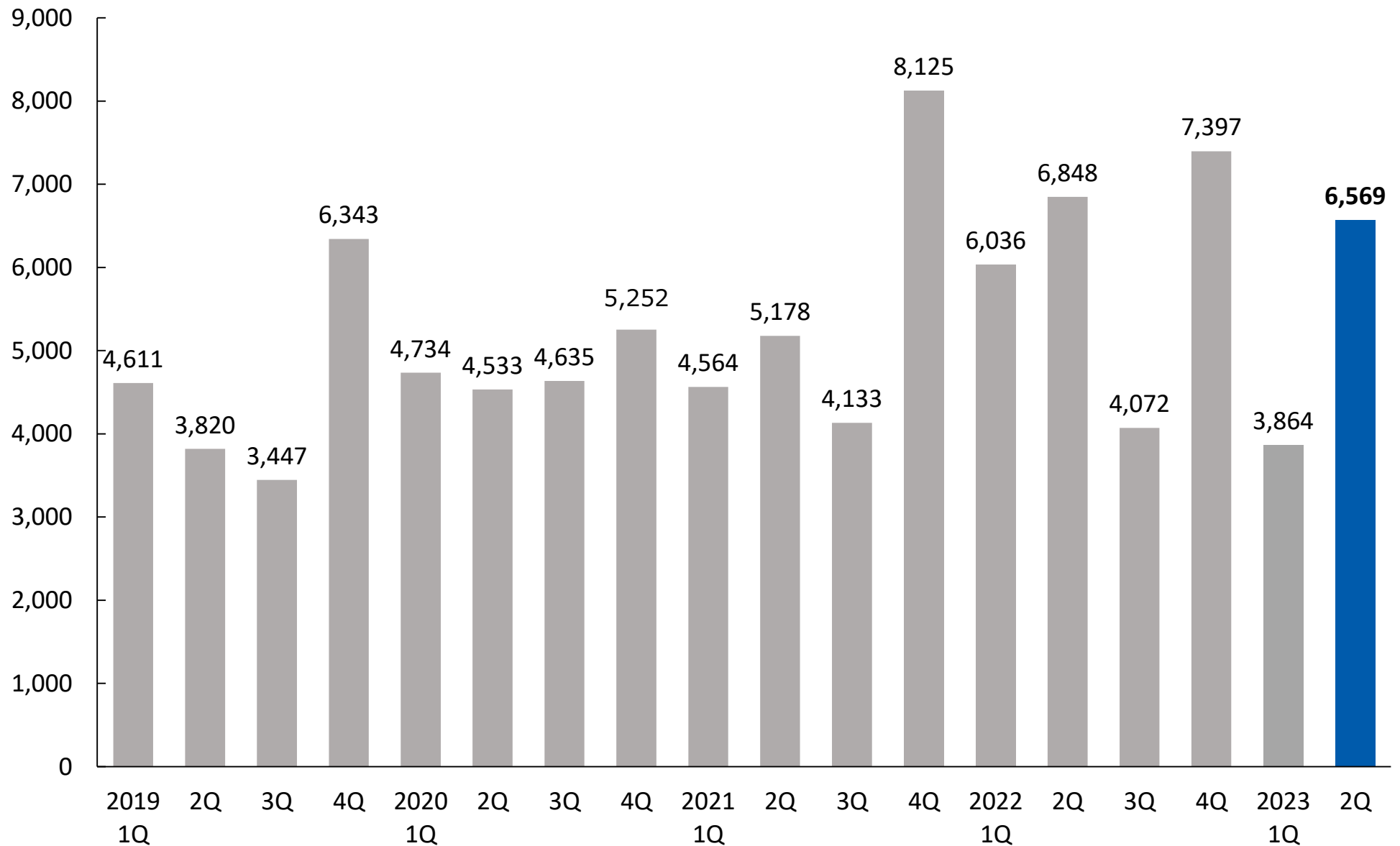
	'22年 2Q	'23年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
売上高	12,885	10,434	—	31,423	33.2
売上総利益	3,469	2,862	27.4	—	—
販管費	2,180	2,322	22.3	—	—
営業利益	1,289	539	—	3,118	17.3
経常利益	1,725	706	—	3,087	22.9
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,246	137	—	2,109	6.5

売上高は前年同期比で19%減。営業利益も前年同期比58.1%減

2Q計画達成率売上高76.6%、営業利益45.4%、経常利益60.3%、四半期純利益17.1%

装置の検収遅延による売上高減少が要因

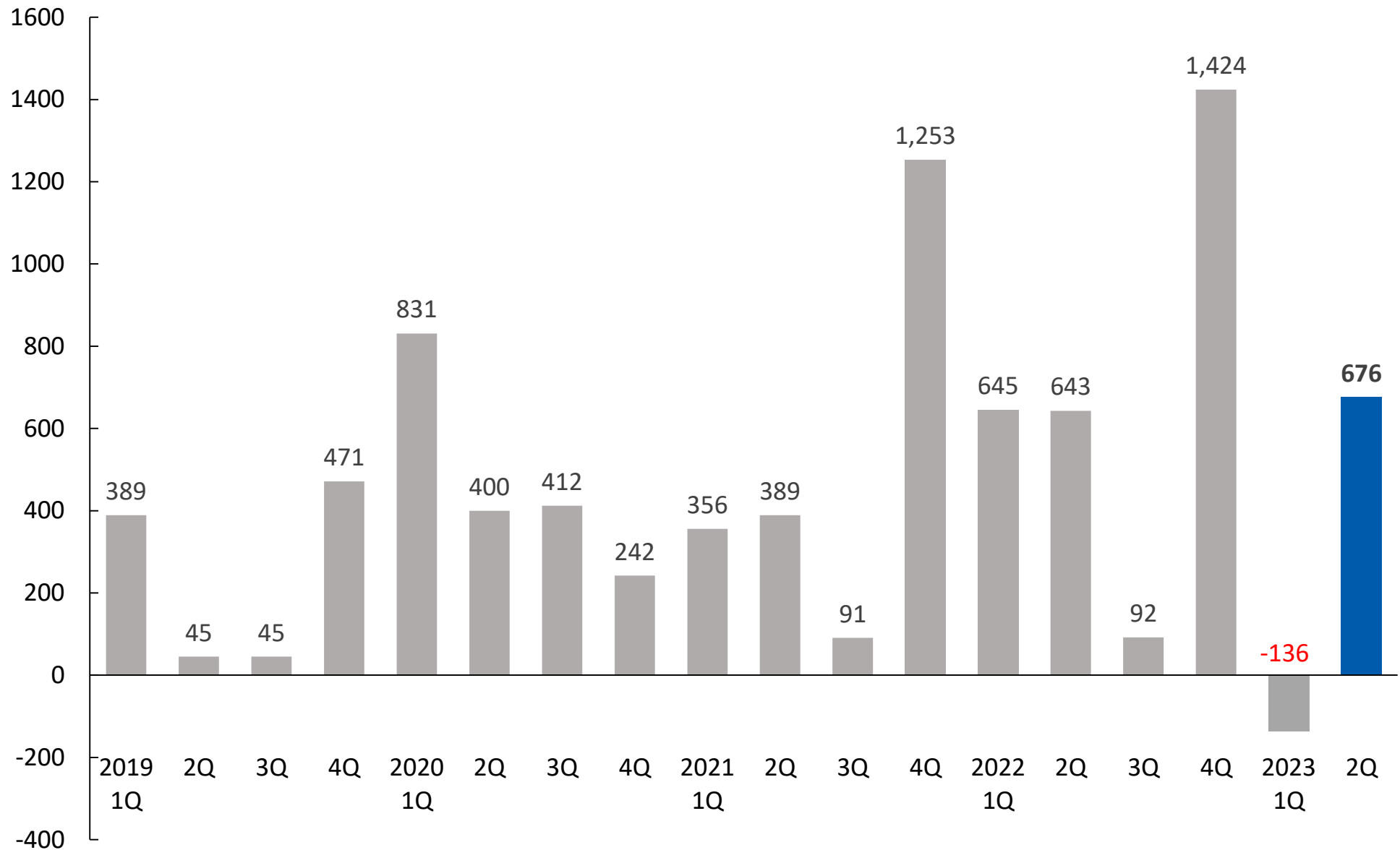
単位：百万円



連結営業利益推移

TAZMO

単位：百万円



連結貸借対照表

TAZMO

単位：百万円

	'22年12月期	'23年2Q	増減
流動資産	31,905	35,858	3,952
有形固定資産	6,267	6,381	113
無形固定資産	198	228	30
投資その他資産	1,025	778	△247
総資産	39,397	43,247	3,850
流動負債	18,463	18,433	△29
固定負債	3,384	6,690	3,306
純資産	17,549	18,122	573
自己資本比率	43.9%	41.2%	△2.7

単位：百万円

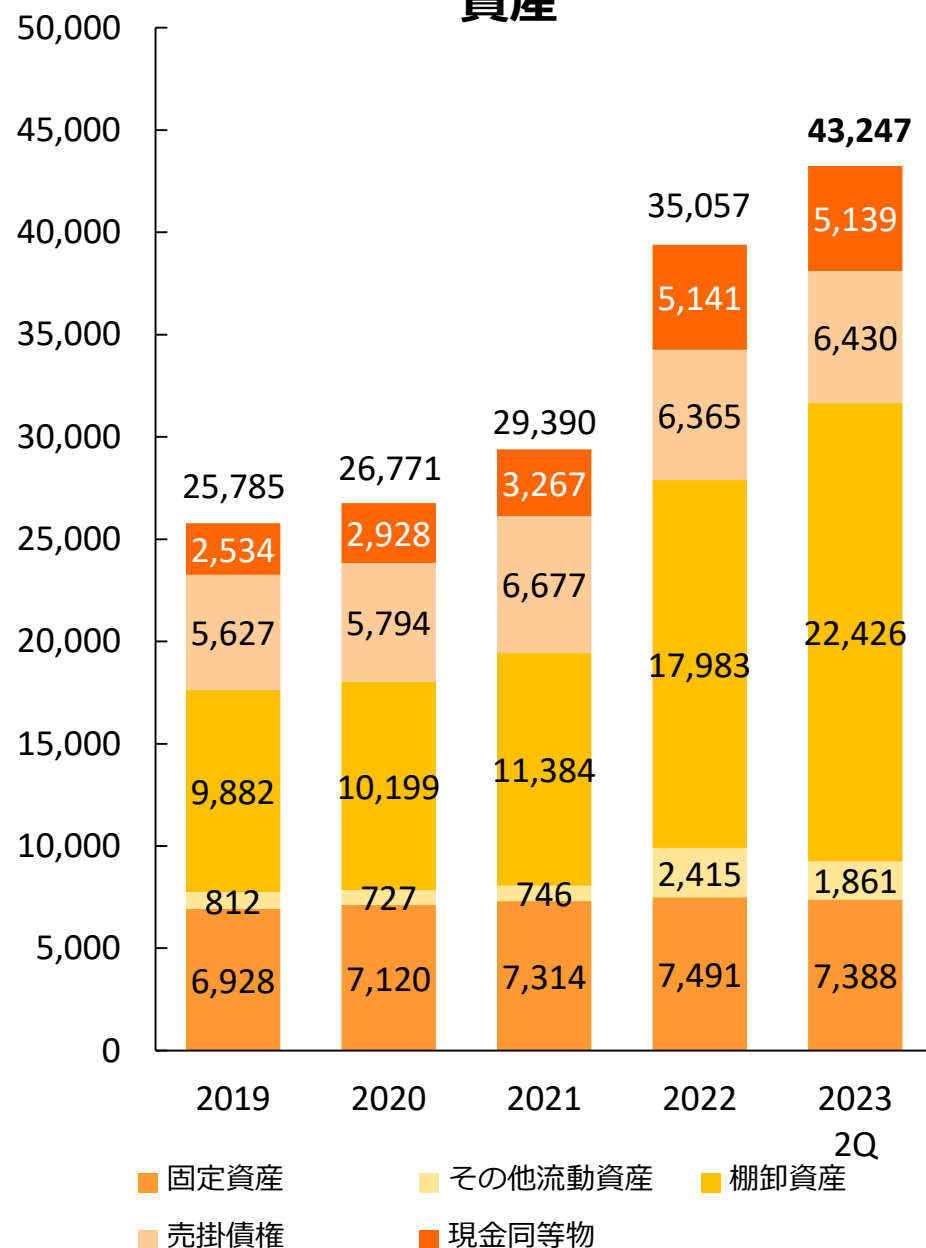
主な増減		
資産		
	'23年2Q	前期末比
受取手形及び売掛金	4,052	△443
電子記録債権	2,378	509
棚卸資産	22,426	4,442
負債		
	'23年2Q	前期末比
電子記録債務	3,851	△499
短期借入金	4,687	△592
未払金	1,278	△306
契約負債	5,570	1,878
有償支給取引に係る負債	—	△577
長期借入金	6,032	3,389

資産・負債／純資産推移

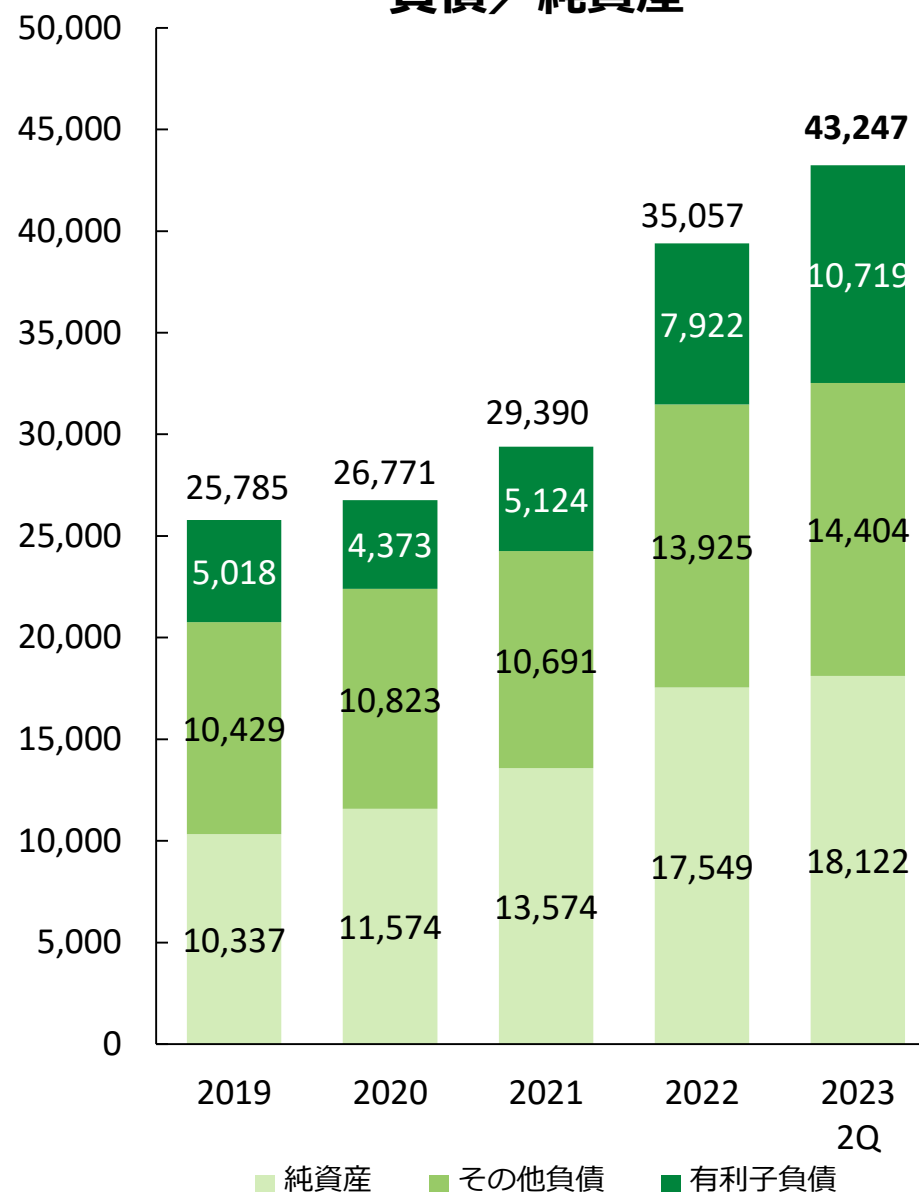
TAZMO

単位：百万円

資産



負債／純資産



セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円

	'22年 2Q	'23年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
売上高	12,885	10,434	—	31,423	33.2
プロセス機器事業	9,977	7,857	75.3	22,974	34.2
半導体装置	2,709	1,731	16.6	8,222	21.1
搬送機器	3,479	3,964	38.0	7,453	53.2
洗浄機	1,229	1,640	15.7	4,412	37.2
コーター	2,558	520	5.0	2,885	18.0
金型・樹脂成形事業	815	769	7.4	2,156	35.7
表面処理用機器事業	2,091	1,807	17.3	6,292	28.7

主に半導体装置・表面処理で検収遅れが複数案件発生し、計画未達となった

半導体装置：前年同期比36.1%減 2Q計画達成率51.9%と大きく計画未達

搬送機器：前年同期比13.9%増 2Q計画達成率108.2%と順調に推移

洗浄機：前年同期比33.4%増 2Q計画達成率94.9%とほぼ計画通り

コーター：売上案件少なく前年同期比79.7%減 2Q計画達成率59.1%と大きく計画未達

表面処理：前年同期比13.6%減 2Q計画達成率61.6%と大きく計画未達

セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円

単位：百万円	'22年 2Q	'23年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
営業利益	1,289	539	—	3,118	17.3
プロセス機器事業	1,163	703	6.7	2,731	—
金型・樹脂成形事業	27	17	0.2	56	30.4
表面処理用機器事業	101	△139	—	330	—
セグメント間連結消去	△2	△41	—	—	—

プロセス機器事業：半導体装置の売上計画未達が影響 2Q計画達成率73.2%

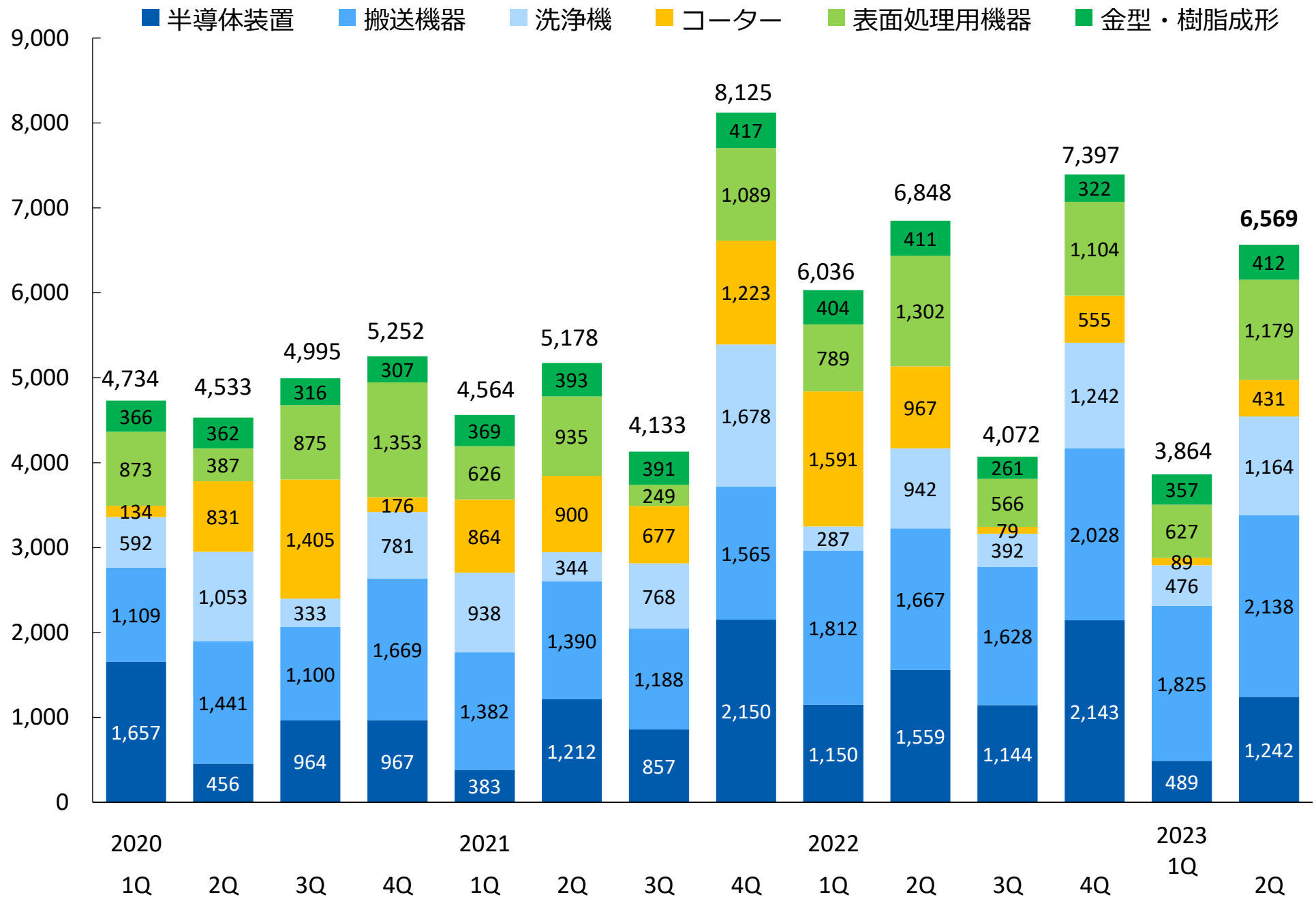
金型・樹脂成形事業：2Q赤字計画から黒字化も 前年同期比37.1%減

表面処理用機器事業：原価率の上昇を吸収できず利益率悪化

セグメント別 売上高推移

TAZMO

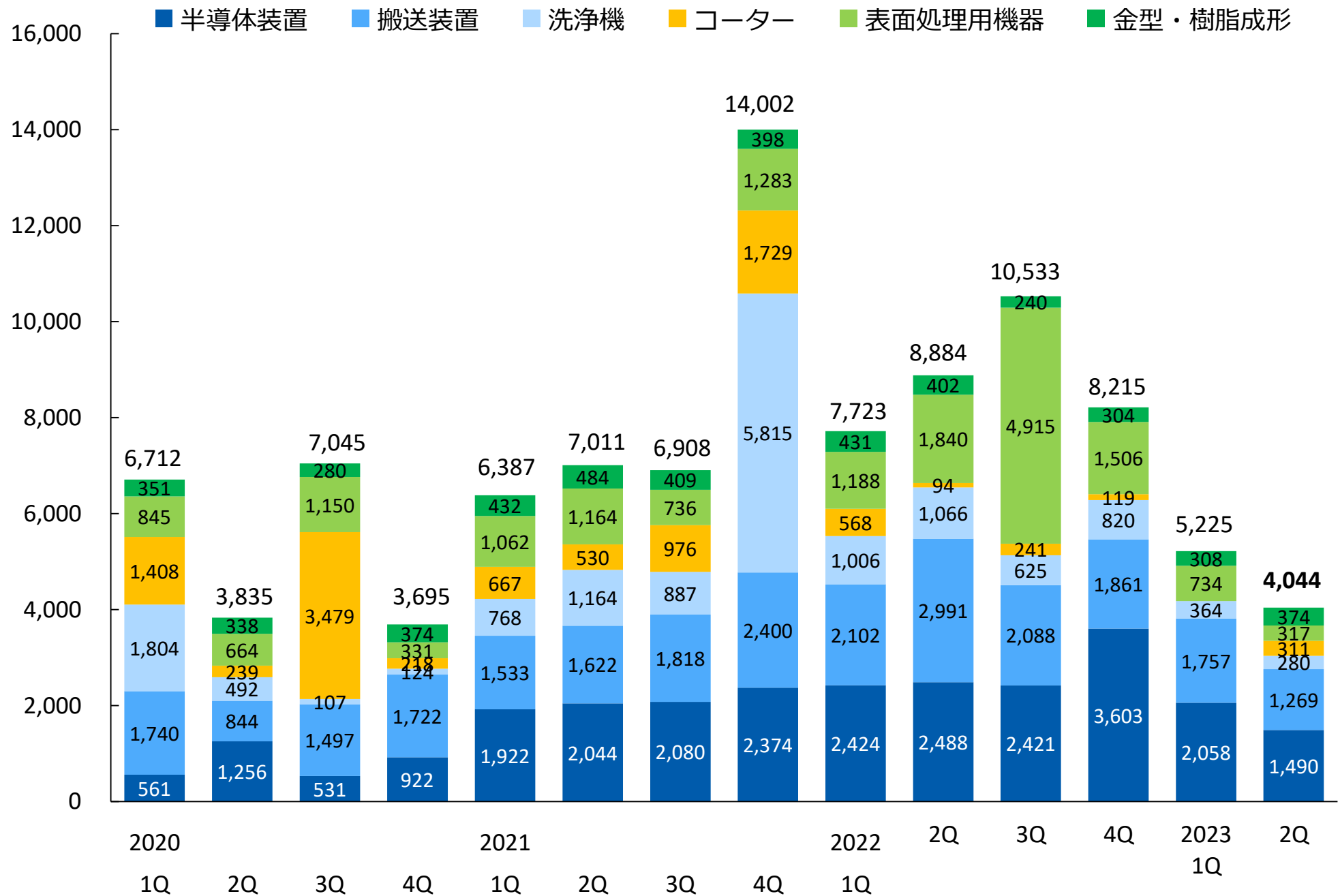
単位：百万円



セグメント別 受注高推移

TAZMO

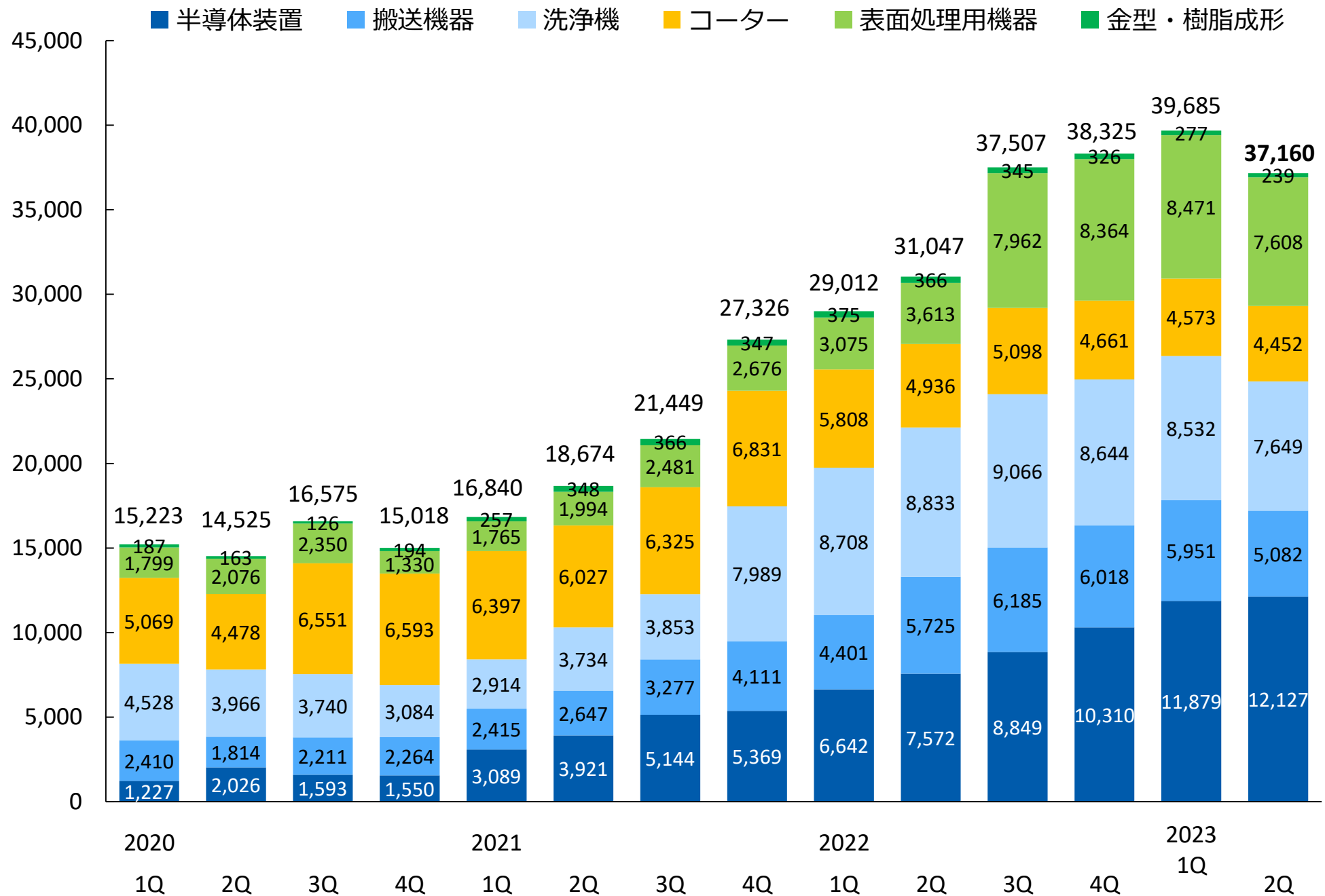
単位：百万円



セグメント別 受注残高推移

TAZMO

単位：百万円



工場建設の遅れ、他社装置入荷の遅れ、お客様の受注タイミングのズレ、生産量調整等、様々な要因により、検収のタイミングの遅延が発生している。半導体業界の減速の長期化による投資抑制及び、一部部品納期の問題も影響していると思われる。

半導体

パワー半導体向けで納入後の立上タイミングの調整を求められることがあり、検収遅れの案件が多くなっている。また、装置納期の長期化に伴い引き合いはいただいているものの、受注までに時間を要している。

生成AI用HPCデバイスの増産計画により、アドバンスドパッケージ向け装置の引合が急増。納期・生産計画を調整中。来年度以降の事業の柱となるよう進めている。

搬送

増強した生産キャパにより売上は計画以上で推移している。

メモリー／ロジックの市場状況の影響を受け、受注件数は低下してきている。

表面処理

生産能力一杯で設計・製造すすめるも、売上計画よりも遅延気味に推移している。

国内外共に引合いは多く、納入時期に合わせた生産計画を調整し受注に結びつけている。

部品調達

全体的に部品の入手性は改善したが、一部の部品が未だ入手困難な状況にあり、製品出荷のボトルネックとなっている

人としての優しさと卓越した想像力を基本に、
あくなき「**挑戦**」によって、豊かな未来社会の創造に貢献する

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万6,587円
発行済株式数	14,836,691株
株主数	3,869名（2023年6月30日現在）
従業員数	単体 374名/連結 1,137名（2023年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、 めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品 などの開発・製造・販売



- 1972 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980 インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
スパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994 エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995 インジェクション成形品の製造・販売を開始
- 2001 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
- 2004 JASDAQ市場に株式を上場
- 2008 TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

2009 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

2013 アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化

ハノイ省ハノイ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築

2017 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化

2018 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2019 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

2020 アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

2022 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行

公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資

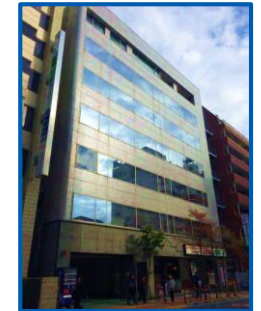
中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立



タツモ第1工場



ファシリティ
出雲研究所



タツモ東京営業所



タツモ第3工場



タツモ第5工場

島根県出雲市

東京都新宿区



ファシリティ本社

岡山県井原市

神奈川県相模原市

岡山県岡山市



クオークテクノロジー



プレテック



タツモ本社



富萊得科技(東莞)有限公司



富萊得(香港)有限公司



龍雲阿普理夏电子科技有限公司



上海龍雲精密機械有限公司

東莞

香港

上海

サンフランシスコ

紹興

ベトナム

台湾



龍雲(紹興)半導体設備
科技有限公司



TAZMO INC



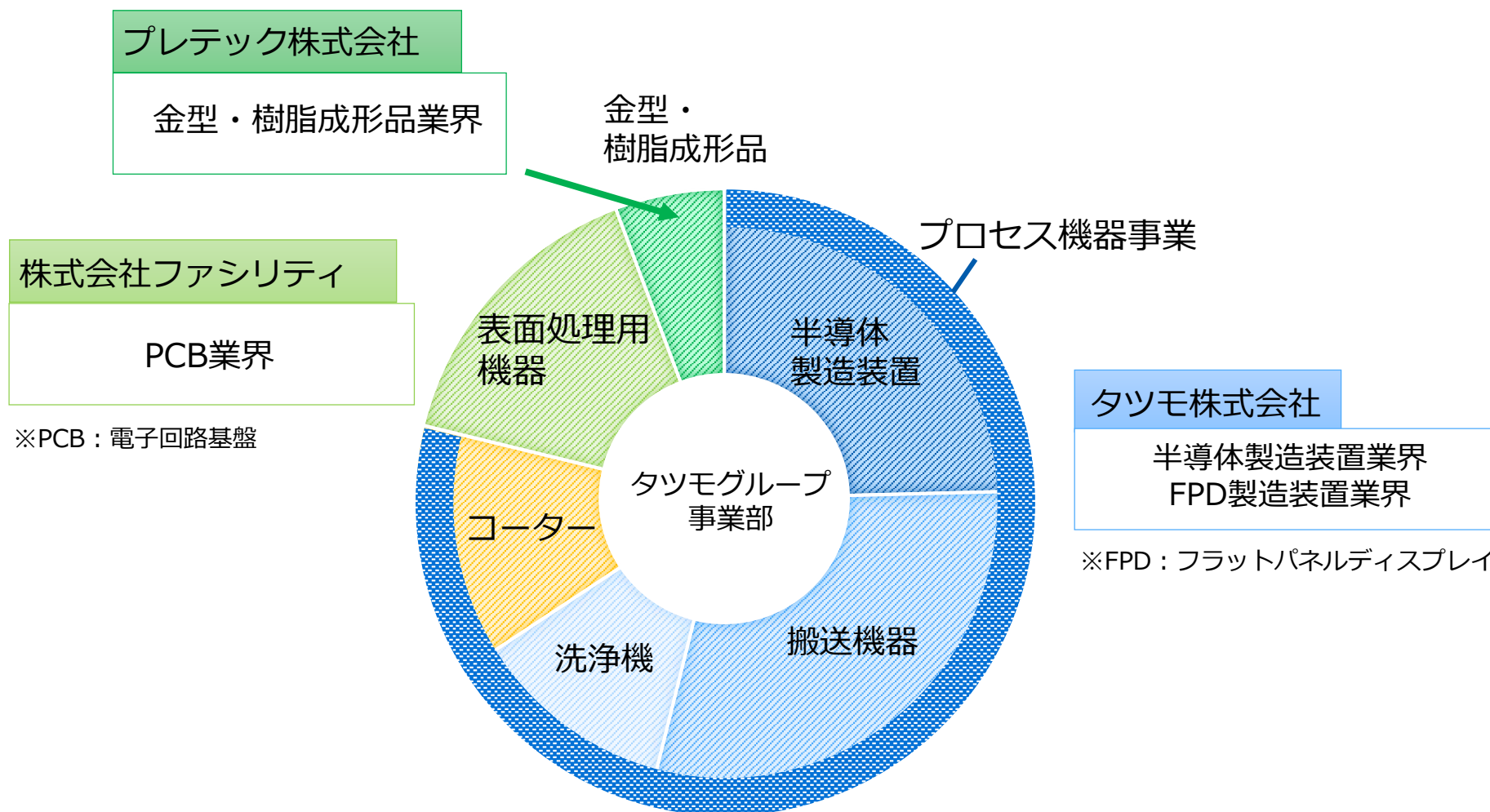
TAZMO VIETNAM CO.,LTD.



FACILITY HANOI CO.,LTD.



龍雲亞普恩科技股份有限公司



半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売



搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットやアライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した製品等の開発・製造・販売



洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売



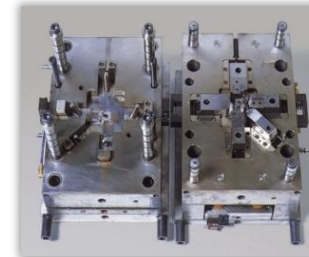
コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発・製造・販売



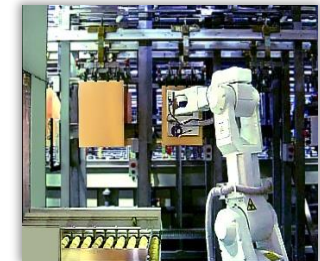
金型・樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使ったコネクタ等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売



本資料の取扱い上の注意

本資料は、2023年8月10日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載されて無いように基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

TEL 086-239-5000

FAX 086-239-5100

Email keiki@tazmo.co.jp



TAZMO